



中华人民共和国电子工业行业标准

SJ/T 10243~10246—91

微波陶瓷介质材料

1991-05-28 发布

1991-12-01 实施

中华人民共和国机械电子工业部 发布

目 录

SJ/T 10243—91	微波集成电路用氧化铝陶瓷基片	(1)
SJ/T 10244—91	微波介质金红石	(6)
SJ/T 10245—91	复合微波介质基片	(9)
SJ/T 10246—91	微波介质材料 A—陶瓷	(12)

中华人民共和国电子工业行业标准

微波集成电路用氧化铝陶瓷基片

SJ/T 10243—91

Alumina ceramic substrates
for microwave integrated circuits

1 主题内容与适用范围

本标准规定了微波集成电路用氧化铝陶瓷基片的结构尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于微波集成电路用氧化铝陶瓷基片(以下简称基片)。

2 引用标准

GB 1031	表面粗糙度参数及其数值
GB 1958	形状和位置公差检测规定
GB 2413	压电陶瓷材料体积密度测量方法
GB 2828	逐批检查计数抽样程序及抽样表
GB 2829	周期检查计数抽样程序及抽样表
GB 5592	电子元器件结构陶瓷材料的名称和牌号的命名方法
GB 5593	电子元器件结构陶瓷材料
GB 5594.3	电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 平均线膨胀系数测试方法
GB 5594.4	电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 介质损耗角正切值的测试方法
GB 5594.5	电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 体积电阻率测试方法
GB 6598	氧化铍瓷导热系数测试方法
GB 9531	电子陶瓷零件技术条件
GB/T 12636	微波介质基片复介电常数带状线测试方法

3 结构尺寸

3.1 基片的长、宽、厚和最小孔尺寸列于表1。

表 1

mm

长×宽	厚 度	最 小 孔 尺 寸
≤(170×170)的所有尺寸	0.2~1.0	最小直径 $\phi 0.25$ 最小边长 0.40

3.2 相邻两孔之间的壁厚或边与孔间距离不小于基片的厚度,且不小于 0.5mm。